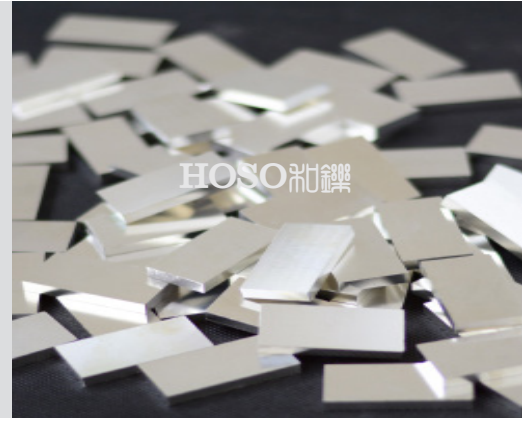


## HOSOPM® 1 系列

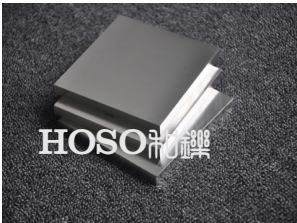
我公司有超过十年生产银钨合金的经验。我公司的银钨合金遵循 GB/T8320-2003 和 ASTM B631标准。HOSOPM®1 系列等同于国际牌号2088, 20S, 30S, 35S, 50S, 4050, 20SB, 35SB, 2110, 2150



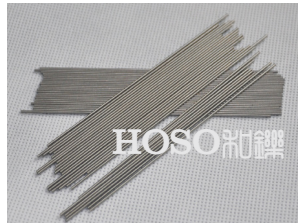
### HOSOPM®1 系列合金是您的最佳选择:

- 高导电，高热导率
- 内部均匀无孔洞杂质
- 采用真空熔渗工艺，含气量低

### 银钨合金产品实例图:



银钨板



银钨棒 直径1mm



银钨触头



银钨触指

### 银钨技术指标

材料	含量 (wt.%)	密度 (g/cm <sup>3</sup> )	电导率 (%IACS)	硬度 (HRB)
HOSOPM®165	Ag35W65	14.5	48	75
HOSOPM®170	Ag30W70	14.9	45	82
HOSOPM®175	Ag25W75	15.4	41	86

● 以上指标均为参考典型值，不得作为产品验收的标准

### 银钨棒材常规尺寸：单位mm

	直径	长度	说明
圆棒	1-60	100, 175, 200, 300	最小直径0.5毫米，长度跟直径根据工艺匹配，详情请咨询和铄。和铄编码：RD1200.170
	厚度	长，宽	说明
方板	1-40	100x200, 200x300, 200x400	最小厚度1mm，长宽与工艺匹配，详情咨询和铄和铄编码举例：PL10100100.170

深圳市和铄金属有限公司  
 地址：深圳市宝安区沙井步涌北方永发高新科技园E栋1楼东  
 电话：+86 755 2907 6552  
 传真：+86 755 2163 8578  
 邮件：info@hosocorp.com



www.hosocorp.com